

DDIC返修流程
DDIC Repaired SOP

拆解
Removed

DDIC 移除
DDIC Removed

FPC 移除
FPC Removed

清洗
Cleaning

DDIC 清洗
DDIC Cleaning

FPC 清洗
FPC Cleaning

ITO 清洗
ITO Cleaning

镜检
Microscopy

DDIC 镜检
DDIC Microscopy

ITO 镜检
ITO Microscopy

DDIC邦定
DDIC Bonding

ACF 贴附
ACF Laminating

COP预压
COP Pre-bonding

COP本压
COP Main-bonding

FOP邦定
FOP Bonding

FOP 假压测试
FOP Testing

ACF 贴附
ACF Laminating

FOP 邦定
FOP Bonding

材料：COP09、酒精

设备：拆机片、镊子、加热台

方法：液体浸泡

环境：无要求

IC06、酒精、清水、纳米海绵

烧杯、加热台、镊子

液体浸泡

无要求

无

金相显微镜、IC托盘

镜检

无尘空间

ACF、铁氟龙

EN-801S、EN-580

COP邦定流程

无尘空间

ACF、铁氟龙

EN-52T、EN-580

FOP邦定流程

无尘空间